

证券代码：688260

证券简称：昀冢科技

苏州昀冢电子科技股份有限公司

（昆山市周市镇宋家港路 269 号）



2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿）

二〇二六年九月

一、本次募集资金使用计划

为进一步增强公司综合竞争力，根据公司发展需要，拟向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过 81,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”以及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	DPC 智能化产线技改扩建项目	18,000.00	17,050.00
2	片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目	35,000.00	25,440.00
3	高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目	18,993.10	18,993.10
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	19,516.90	19,516.90
合计		91,510.00	81,000.00

募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金投资金额，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目概况

1、DPC 智能化产线技改扩建项目

本项目拟投资 18,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 17,050.00 万元，主要投资内容包括场地装修改造、设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资，主

要用于生产陶瓷热沉及 T/R 管壳产品。陶瓷热沉包括氮化铝、氧化铍、碳化硅等产品，主要用于高功率激光器、激光加工、激光焊接等领域。T/R 管壳是公司于 2024 年开始量产的新产品，其基于 DPC 陶瓷基板工艺制备的有源相控阵 T/R 组件核心封装载体，通过高精度图形化线路与金属化腔体结构，为射频芯片提供电气互联、物理支撑及散热通路。该产品推动 T/R 组件由传统离散组装向一体化封装变革，凭借垂直互联与收发分区腔体设计，实现了小型化、轻量化及高集成度，显著缩短散热与信号传输路径，在提升信号完整性的同时具备优异的气密性与高可靠性，主要用于 5G 通讯、雷达卫星等领域。项目计划对当前 DPC 业务产线进行自动化、智能化、柔性化技术升级改造，加快实现上述产品规模化发展，持续扩大现有客户合作能力，并为新客户的开拓合作提供产能支撑，进一步释放公司业务增长潜力，实现公司电子陶瓷产品整体向高附加值产品的转换，推动业务新增长极。

2、片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目

本项目拟投资 35,000.00 万元，其中拟使用募集资金金额 25,440.00 万元，主要投资内容包括设备购置及安装、铺底流动资金等必要投资。项目主要为进一步推动公司电子陶瓷业务中长期策略发展方向，计划通过新增生产线、优化生产布局、升级现有产能等方式，提升 MLCC 产品的整体产能供给能力，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，夯实业务新增长曲线底层支撑，助力公司加强 MLCC 业务的市场优势，推动业务规模与盈利能力持续提升。

3、高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目

本项目拟投资 18,993.10 万元，其中拟使用募集资金金额 18,993.10 万元，均用于设备购置及安装。本项目计划通过购置先进设备并应用创新生产技术，提高生产效率并降低生产能耗，同时进一步扩增公司 MLCC 高容产品系列品项，提升公司 MLCC 业务规模及竞争力。

4、补充流动资金及偿还银行贷款项目

公司基于业务快速发展对流动资金的需求，拟使用本次募集资金中 19,516.90 万元补充流动资金及偿还银行贷款，以满足公司经营资金需求，优化资产结构，降低财务费用，增强公司的抗风险能力。

（二）项目实施必要性

1、积极拓展公司业务布局，推动业务新增长极及公司中长期发展战略落地

近年来，公司在稳固消费电子主营业务优势的同时，积极布局电子陶瓷新赛道，旨在培育业务增长点、构建更具韧性与竞争力的业务生态。

DPC 产品具有导热/耐热性好、图形精度高、可垂直互连及热膨胀系数与芯片匹配等特性，未来在工业激光、车载激光、航天卫星、光通信等高端应用领域拥有广阔的应用前景。其作为公司电子陶瓷领域的核心拓展方向之一，已于 2024 年取得关键性突破，产品切入激光热沉、T/R 管壳等领域，业务呈现快速增长的积极态势。基于这一良好发展基础，公司需进一步加大该业务的投资力度，推动其成为新增长极，助力整体业务持续升级。

MLCC 作为全球用量最大、发展最快的片式电子元器件之一，凭借千亿级市场规模、下游需求高增长、应用场景广覆盖及显著的国产替代空间，成为电子元器件产业中极具战略价值的赛道。基于此，公司明确将 MLCC 纳入中长期策略发展重点方向，将其作为夯实业务新增长曲线的关键抓手，持续加大研发投入与生产布局力度。公司目前已实现 0201、0402、0603、0805、1206 等多尺寸系列产品的研发及生产，可满足下游多领域应用需求。同时正加速更高规格产品的核心技术攻关与市场拓展，进一步完善产品矩阵，逐步覆盖更高价值的应用场景，为公司构建长期、稳定的新增长曲线筑牢底层支撑。

本次募投项目计划对 DPC 和 MLCC 产线进行技术升级改造，快速提升电子陶瓷业务产能规模与质量稳定性，并为更高规格产品的研发生产提供硬件支撑，夯实业务新增长曲线底层基础，推动公司中长期战略稳步落地。

2、通过 DPC 产线升级改造，实现向高附加值产品转换

在公司 DPC 业务发展初期，产品主要应用于 LED 陶瓷热沉基板领域。伴随着工业激光设备及 T/R 管壳国产化趋势，公司积极跟进上述领域陶瓷热沉及管壳产品需求，致力于推动相关产品国产化进程，填补相关国产组件市场需求，向更高产品附加值领域迈进。经过多年的技术研发及市场开拓，目前公司产品已成功切入上述领域，相关产品出货量实现快速增长。

本次募投计划通过对 DPC 业务部分老旧产线进行淘汰及改造，满足工业激光设备、航天卫星、光通信等下游领域产品生产要求。项目有利于实现公司陶瓷

基板产品整体向高附加值产品的转换，增强公司业务盈利水平，抓住市场机遇，保障公司未来的可持续发展。

3、助力 MLCC 国产化，填补高容产品需求

MLCC 作为电子电路中的核心被动元器件，广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域，其供应链安全与自主可控对我国电子信息产业发展至关重要。当前，国内中低端 MLCC 产能已逐步实现自主供应，但在高容量、高可靠性等高端 MLCC 产品领域，仍存在一定进口依赖，尤其随着新能源汽车、5G 通信、AI 等下游行业快速发展，高容 MLCC 市场需求持续攀升，供需缺口成为制约产业链升级的关键环节。在此背景下，助力 MLCC 国产化替代、填补高容产品需求，既是突破供应链难题的重要举措，也是推动国内电子元器件产业向高端化升级的核心方向。

本次募投计划通过对现有产线进行技术升级改造，优化生产工艺，进一步提升公司高容产品良率、稳定性及生产规模，帮助满足国内下游终端企业对高容 MLCC 的迫切需求，降低产业链采购成本与供应链风险，完善国内 MLCC 产业生态，提升我国在全球电子元器件领域的核心竞争力，为我国电子信息产业高质量发展筑牢基础。

4、加强产品生产能力，匹配业务增长需求

经过长期技术探索、多轮严格测试验证以及积极的客户开拓工作，公司大功率激光用热沉及 T/R 管壳产品凭借高可靠性能与品质获得了客户的认可，不仅成功获取了稳定订单，产品市场需求更是实现快速攀升，但当前产能不足的核心瓶颈十分突出，现有产能仅能勉强满足少数合作客户的供应需求，供货能力的短缺不仅让公司错失了大量潜在客户的合作机会，更严重制约了新客户拓展的步伐，难以进一步扩大市场份额、释放业务增长潜力。公司 MLCC 业务亦呈现显著增长态势，产品市场需求持续攀升，公司 MLCC 产品产销衔接高效，已基本实现“产出即销售”的良好局面，生产线长期保持满负荷运行状态，现有产能已难以进一步承接新增订单。

本次募投计划通过进一步扩大 DPC 和 MLCC 业务生产规模，突破因产能不足所导致的现有市场份额边界，持续扩大与现有客户合作能力，并为新客户、新应用场景的开拓提供产能支撑，推动业务规模与盈利能力持续提升。

5、满足业务扩张资金需求，优化资本结构

近年来，公司在稳固消费电子业务的同时，积极布局汽车电子与电子陶瓷等新赛道，业务快速扩张使得流动资金需求也随之增加。此外，截至 2026 年 6 月 30 日，公司资产负债率为 89.20%，已处于较高水平。

本次向特定对象发行股票募集资金部分拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。这一举措既能缓解业务扩张带来的资金缺口，为人才建设、研发投入及日常运营提供支持，巩固行业地位；又能有效优化公司资本结构，降低资产负债率，提升公司抗风险能力与综合竞争力，保障公司长期稳定发展。

（三）项目实施可行性

1、项目建设符合国家相关政策导向

本次募投项目涉及的 DPC 陶瓷基板与 MLCC 产品，均属于国家战略性新兴产业的重点支持范畴。近年来，国家陆续出台《“十四五”原材料工业发展规划》、《基础电子元器件产业发展行动计划》、《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等多项重磅文件，明确将高端电子陶瓷材料、高端热沉器件、核心电子元器件列为重点发展对象，强调提升产业链自主可控能力与可靠性水平。

本次募投旨在扩大 DPC 陶瓷基板及高容 MLCC 产品的产能，契合国家产业政策导向，相关政策将为本次募投的顺利实施与落地提供有力支持。

2、下游市场需求的快速增长为项目实施提供良好保障

在 DPC 陶瓷基板应用方面，受益激光产业升级及卫星互联网建设，下游需求旺盛。根据《2025 中国激光产业发展报告》数据显示，2024 年，全球激光设备市场销售收入约为 218 亿美元，其中中国激光设备市场销售收入约 897 亿元，占比达到全球市场的 56.6%，保持稳步增长。同时，公司 T/R 管壳主要应用于雷达及卫星领域。根据 AIIOT 星图研究院数据，2023 年我国车载激光雷达出货量约为 71 万台，预计 2027 年出货量将达到 857 万台。在卫星领域，根据 BryceTech 数据显示，2024 年全球发射小卫星 2,790 颗，创历史新高，其中通信卫星比例在 2019 年后显著增加，最近几年占比均超过 70%；近 10 年小卫星发射次数由 2015 年的 33 次，快速增长至 2024 年的 199 次，预计未来卫星发射数量仍将持续攀升。车载激光雷达及卫星发射数量的爆发式增长，直接拉动了对 T/R 管壳的需求。

在 MLCC 应用方面，行业已走出周期低谷，重回增长轨道。根据赛迪顾问数据显示，2024 年全球及中国 MLCC 市场规模分别达 231.3 亿美元和 544.4 亿元，同比增长分别达到 7.5%和 11.9%。随着 5G 通信、汽车电子、人工智能等领域的技术突破与市场扩张，全球 MLCC 市场需求将迎来爆发式增长，预计从 2024 年的 231.3 亿美元增长到 2027 年的 334.1 亿美元，年复合增长率达 13.0%。

下游市场需求的快速增长为本次募投的产能消化提供了良好保障。

3、优秀的产品性能及优质的客户资源为项目实施奠定坚实基础

在 DPC 陶瓷基板领域，公司已实现从技术突破到规模化量产的跨越，是行业内少有实现 100%全流程自制的制造商。公司产品在尺寸精度、平整度、均匀性、稳定性等方面上表现优异，并已成功导入行业头部客户供应链，客户粘性强，订单放量趋势明确。在 MLCC 领域，公司虽为行业后起之秀，但凭借长期扎实的研发积累与严苛的测试验证，在产品性能上已建立起口碑优势。市场端，公司已与业内知名经销商建立了长期稳固的战略合作关系，渠道通路顺畅，品牌知名度和认可度快速提升。

优秀的产品性能优势与优质的客户储备，为本次募投项目的顺利实施与产能消化奠定了坚实基础。

4、公司实力雄厚的核心团队与技术优势有效保障本项目的顺利实施

DPC 业务方面，公司组建了专注于高导热陶瓷线路板工艺开发与量产的资深技术团队，拥有覆盖产品设计开发、DPC 基板生产、表面处理、质量检测至贵金属回收制备的全流程自制能力，核心生产工艺与关键设备全面自主可控，从而既提升了生产效率和产品质量稳定性，又通过成本控制强化了竞争力。MLCC 业务方面，公司自 2021 年组建核心团队，部分骨干成员来自头部 MLCC 企业，已逐步攻克材料配方、精密印刷、叠层烧结等核心技术，有效降低对进口材料的依赖，实现部分关键材料自主可控。同时，依托公司自动化设备技术支持，已完成部分核心生产设备的自主开发，可显著提升产线智能化水平，推动产品良率持续改善，降低生产制造成本。

公司核心团队凭借深厚的行业经验与技术积累，为项目技改扩产提供保障。

5、本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件，公司具备完善的法人治理结构和内部控制体系

本次向特定对象发行股票募集资金拟部分用于补充流动资金及偿还银行贷款，符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规，发行方案合法合规，具备可行性。

同时，公司已建立健全规范的法人治理结构及内部控制体系，并制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用及监督进行全流程规范，能够保障本次募集资金的安全、合规使用，有效防范财务风险。

（四）项目投资概算和进度安排

1、DPC 智能化产线技改扩建项目

（1）投资金额

“DPC 智能化产线技改扩建项目”计划投资总额为 18,000.00 万元，拟投入募集资金 17,050.00 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	场地装修改造	2,850.00	15.83%
2	设备购置及安装	14,719.00	81.77%
3	铺底流动资金	431.00	2.39%
合计		18,000.00	100.00%

（2）建设周期

本项目计划建设周期为 2 年。

（3）项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已取得备案文件及环评批复。

2、片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目

（1）投资金额

“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”计划投资总额为 35,000.00 万元，拟投入募集资金 25,440.00 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	设备购置及安装	34,538.00	98.68%
2	铺底流动资金	462.00	1.32%
合计		35,000.00	100.00%

(2) 建设周期

本项目计划建设周期为 2 年。

(3) 项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已取得备案文件及环评批复。

3、高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目

(1) 投资金额

“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”计划投资总额为 18,993.10 万元，拟投入募集资金 18,993.10 万元，项目具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	占比
1	设备购置及安装	18,993.10	100.00%
合计		18,993.10	100.00%

(2) 建设周期

本项目计划建设周期为 1 年。

(3) 项目涉及报批事项情况

截至本报告公告日，本项目已取得备案文件及环评批复。

三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

(一) 本次发行对公司经营管理的影响

公司本次募集资金将用于“DPC 智能化产线技改扩建项目”“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”“高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目”及“补充流动资金及偿还银行贷款项目”，是公司为顺应公司战略发展而做出的重要布局。DPC 智能化产线技改扩建项目、片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目及高容量系列多层片式陶瓷电容器产业化技改项目均是基于公司中长期发展战略以及当前公司电子陶瓷产品营收实现快速放量的态势下，通过对产线进行技改升级，提升相关产品的整体产能供给能力，并满足公司高规格产品的生产要素，进一步释放公司业务增长潜力，推动公司业务新增长极。补充流动资金及偿还银行贷款项目则是通过注入流动性资金与降低债务负担，缓解公司资金周转压力，助力业务正向发展。

本次发行能够进一步提升公司的资本实力，增强公司的技术实力和服务能力，从而进一步提升公司品牌影响力、扩大公司市场占有率，巩固公司的行业地位，提高盈利水平和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产将同时增加，资金实力将有所提升，财务状况将有所改善，抗风险能力将进一步提升。但由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，可能在短期内难以实现预期效益，存在每股收益等指标在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目具有良好的市场前景、经济效益和社会效益，未来随着项目的运营实施，公司的经营规模和盈利水平将进一步增强，财务状况得到进一步改善，最终将会推动公司的业务规模和盈利能力进一步提升。

四、募集资金投资项目可行性分析结论

综上所述，公司本次向特定对象发行股票募集资金投向符合国家产业政策及行业发展趋势，与目前上市公司的主营业务紧密相关，符合公司未来发展的战略规划。本项目的实施将进一步提升公司的核心竞争力和服务能力，巩固公司市场地位，增强公司的综合实力，符合公司及全体股东的利益。因此，本次向特定对象发行股票募集资金是必要的、可行的。

苏州昀冢电子科技股份有限公司

2026年9月18日